

Press Release

2024年1月10日

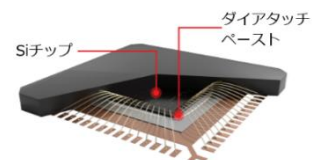
初回から日本最大規模「第1回 パワーデバイス&モジュール EXPO」に出展 ヘンケルジャパン、第38回 ネプコンジャパンにて 半導体・電子部品向け最新の材料・テクノロジーを一挙公開

ドイツの化学・消費財メーカー ヘンケルの日本法人ヘンケルジャパン株式会社(本社:東京都品川区 代表取締役社長:浅岡 聖二)のエレクトロニクス事業部およびインダストリアル事業部は、2024年1月24日~1月26日東京ビッグサイトにて開催される「第1回 パワーデバイス&モジュール EXPO(第38回 ネプコンジャパン内)」に出展します。車載、コンシューマーデバイス、データセンター/EV 充電設備向けのトータルソリューションを公開、高熱伝導ダイアタッチペストの新製品を日本初展示します。展示会場内で開催される「パワーデバイス&モジュール 最新技術フォーラム」へ登壇、ヘンケルブース内で随時開催される各種セミナーでも最新のテクノロジーを紹介します。

展示製品

車載向けテクノロジー

■ **LOCTITE®高熱伝導ダイアタッチペスト【新製品/開発品展示有】**
ラミネートとリードフレームの両方のワイヤボンディングパッケージ要件に対応するため、ダイパッド比の向上、より薄いボンドライン、高温耐性、強固な接着性など、さまざまなワイヤボンディング要件に対応する高熱伝導ダイアタッチペスト(プレッシャーレスおよびプレッシャーアシストシンタリングペスト)を開発、日本初展示します。



■ **LOCTITE®ダイアタッチフィルム【新製品/開発品展示有】**

ヘンケルのダイアタッチフィルムはパッケージの小型化と薄型化(高密度化)に貢献、各種パッケージに優れた信頼性をもたらし、プロセスを簡素化します。導電性・非導電性の両方のラインアップを取り揃えています。

■ **LOCTITE®アンダーフィル材【新製品展示有】**

豊富な市場実績をもつヘンケルのアンダーフィル材は、多数の電子部品の製造工程で使用されています。繊細な構成部品の熱サイクル性能を向上させ、はんだ接合部を安定化・強化します。

■ **LOCTITE®イメージセンサーパッケージ用封止材・ダイアタッチ材【開発品展示有】**

イメージセンサーの大型化に伴い課題となる、センサーの反り防止や信頼性の向上に貢献する封止材・ダイアタッチ材を展示します。

コンシューマーデバイス向けテクノロジー

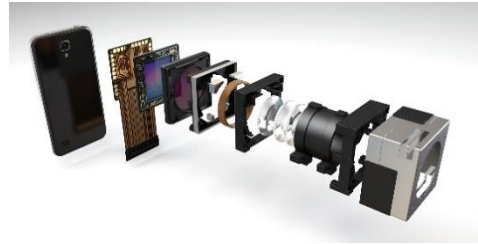
■ **LOCTITE® カメラモジュール用デュアルキュア接着剤**
歩留まり向上に貢献する UV+熱硬化のデュアルキュア接着剤を展示します。

■ **TOF センサーモジュール向け接着剤**
高放熱タイプや TOF センサーモジュールに使用される材質に高い接着強度を発揮する接着剤を展示します。

■ **ディスプレイ表面コーティング材【新製品展示有】**
ディスプレイ表面コーティング InvisiPrint® は、指紋を見えにくくすることで画面の視認性向上に貢献します。また、環境負荷物質であるフッ素化合物(PFAS)を使用していません。

■ **BERGQUIST® サーマルインターフェース材料**
ヘンケルの BERGQUIST® GAP FILLER は、2 液常温硬化タイプの熱伝導性ギャップ充填材料です。ディスペンサーで塗布できるため形状自由度が高く、組立時にスムーズに濡れ拡がるため、部品や基板に負荷がかからず、応力が発生しません。常温放置または加熱により硬化した後は低弾性の熱伝導性ポリマーとなり、エアギャップの無い高効率の熱インターフェースを提供します。

■ **LOCTITE® ポリウレタン系(PUR) 反応性ホットメルト構造用接着剤**
ヘンケルは、幅広いイノベーションポートフォリオを生かして、環境に配慮したエレクトロニクス業界向け製品初のバイオベースポリウレタン系(PUR) 反応性ホットメルト構造用接着剤を開発しました。ヘンケルの反応性ホットメルト接着剤を利用することにより、廃棄物の削減、製造プロセスの自動化・簡易化、トータルコストの低減及びサステナビリティへの貢献が可能です。



データセンター/EV 充電設備向けテクノロジー

■ **LOCTITE®/ BERGQUIST® フェーズチェンジ材料【新製品展示有】**
IGBT・PC プロセッサなどグローバルに豊富な実績を持ち、優れた熱性能をもたらす画期的なフェーズチェンジサーマルインターフェース材料(PCTIM)です。薄いボンドラインとごく低圧及び高圧での低サーマルインピーダンスによってストレスを最小限に抑えながら優れた熱性能を発揮します。

■ **BERGQUIST® 高機能サーマルインターフェース材料【新製品展示有】**
ヘンケルの高性能サーマルインターフェース材料 BERGQUIST® GAP PAD および GAP FILLER を展示します。

■ **LOCTITE® 基板・部品用防湿コーティング剤**
LOCTITE® のコンフォーマルコーティング剤は、無溶剤、速硬化が特長の環境に優しい材料です。

■ **LOCTITE® 熱伝導性ポッティング材【新製品展示有】**
高圧機器の注型、電気・電子部品の封止に最適な優れた熱伝導性と絶縁性を有した注型樹脂です。

■ **TECHNOMELT® ホットメルトモールディング**
低温、低圧で成形ができるため、繊細な電子部品へダメージを与えません。また、3 つのプロセスでモールドが部品を確実に保護し、製品の生産性と信頼性向上に貢献します。

■ **LOCTITE®/ SONDERHOFF 液状ガスケットシール剤**
成形ガスケットに代わるシール剤です。液状であるため、自動化ラインに対応可能で、量産部品のシール剤として適しています。

セミナー

■ パワーデバイス&モジュール 最新技術フォーラム

【講演タイトル】

パワー半導体向け高熱伝導性ダイアタッチ材について

日時: 2024年1月24日(水) 14:00 - 14:30

会場: 東6ホール 特設フォーラム会場

演者: ヘンケルジャパン株式会社エレクトロニクス事業部 Country Manager 加藤竜伸

内容: パワー半導体のチップと基板の接続(ダイアタッチ)に求められる高い熱伝導性を持つヘンケルの高熱伝導性ダイアタッチ材を紹介します。

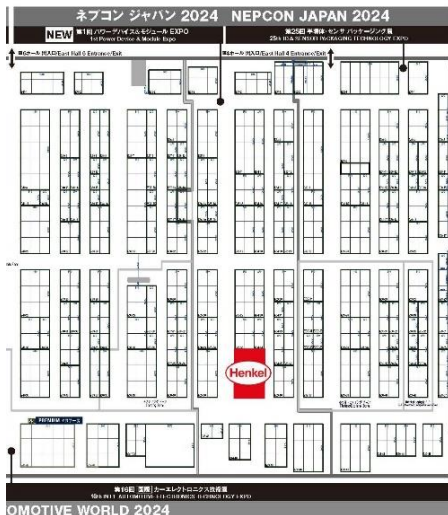
■ ヘンケルジャパンプース内セミナー

ヘンケルジャパンプース内で各種テクノロジーをセミナー形式でご紹介します。

- ・高熱伝導ダイアタッチ材
- ・イメージセンサーパッケージ用材料
- ・カメラモジュール用デュアルキュア接着剤
- ・ディスプレイ表面コーティング材
- ・ホットメルトモールディング
- ・高熱伝導シリコンフリーGAP PAD
- ・相転移型サーマルインターフェース(シート型) 他

ヘンケルジャパンプース詳細

■ ヘンケルジャパンプース番号: E34-38 (東4ホール)



第1回 パワーデバイス&モジュール EXPO

名称: 第1回 パワーデバイス&モジュール EXPO
<https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/about/pdm.html>

第38回 ネプコン ジャパン -エレクトロニクス 開発・実装展-
<https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp.html>

会場: 東京ビッグサイト
<https://www.bigsight.jp/visitor/access/>

会期: 2024年1月24日(水)~26日(金) 10:00~17:00
入場には事前の来場者登録が必要です。来場者登録は[こちら](#)。

主催: RX Japan 株式会社

概要: ネプコンジャパンは、エレクトロニクス機器の多機能化・高性能化を支える世界最先端の電子部品・材料や製造・実装・検査装置が出展する展示会です。

ネプコンジャパンは7展で構成されます。構成展示会の1つであるパワーデバイス&モジュール EXPO は、市場が益々拡大するパワーデバイス・パワーモジュールの専門展です。パワーデバイス・パワーモジュールの部品・材料、製造・検査装置、パワーモジュール製品が出展します。

ヘンケルについて

ヘンケルはブランド、イノベーション、テクノロジーにより、産業およびコンシューマー向け事業において世界中の市場をリードしています。アドヒーズブテクノロジーズ(接着技術)事業部門は接着剤、シーリング剤、機能性コーティング剤市場のグローバルリーダーとなっています。コンシューマーブランド事業部門は特にヘアケアやランドリー&ホームケアの分野において、世界中の市場やカテゴリーをリードする地位を維持しています。ヘンケルには3つの強力なブランド、LOCTITE(ロックタイト)、Persil(パーシル)、Schwarzkopf(シュワルツkopf)があります。2022年度の売上高は220億ユーロを超え、営業利益はおおよそ23億ユーロでした。ヘンケルの優先株は、ドイツ株式指数DAXのリストに入っております。ヘンケルには長いサステナビリティの歴史があり、具体的な目標を掲げた明確なサステナビリティ戦略を推し進めます。1876年に創業したヘンケルは現在、世界に約50,000名の社員を擁し、多様なチームが強固な企業文化、共通の価値観とヘンケルの社員をひとつにまとめる共通基盤である企業目的「Pioneers at heart for the good of generations」の元に結束しています。さらなる情報は[こちら www.henkel.com](http://www.henkel.com)をご覧ください。

ヘンケルジャパンウェブサイト: www.henkel.co.jp

ヘンケルジャパン接着技術事業部門ウェブサイト: www.henkel-adhesives.com/jp

ヘンケルジャパン Facebook: www.facebook.com/HenkelJapan

ヘンケルジャパン接着技術事業部門 YouTube: www.youtube.com/HenkelJapanAdhesiveTechnologies

— 本件に関するお問合せ先 —

ヘンケルジャパン株式会社 接着技術事業部門
マーケティングコミュニケーション 担当: 清 晴世

TEL: 045-758-1784 e-mail: haruyo.sei@henkel.com